

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-015

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“马来西亚槟城金海通”）。
- 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司拟为马来西亚槟城金海通提供不超过人民币 1,500 万元（含美元、林吉特或其他等值货币）的担保。截至本公告披露日，公司已实际为马来西亚槟城金海通提供的担保余额为 0 元，无逾期对外担保情形。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次对外担保已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司马来西亚槟城金海通生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为马来西亚槟城金海通贷款业务提供担保，担保额度预计不超过人民币 1,500 万元（含美元、林吉特或其他等值货币）。具体授信品种、担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述担保额度内与相关方签订担保合同后，公司将按照届时有效的监管规则要求履行担保进展的信息披露义务。

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实

际情况办理相关事宜并签署相关文件。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序

本次为全资子公司提供担保事项已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.
2、注册号码：202301025284(1519207-T)
3、注册地：39 IRVING ROAD 10400 GEORGE TOWN PULAU PINANG
MALAYSIA

4、主要办公地点：PT 5932 Jalan Cassia Selatan 5/2, Taman Perindustrian Batu Kawan, Bandar Cassia, 14110, Penang

5、法定代表人：CHEE CHOON CHYE

6、注册资本：2,303.17万林吉特

7、主营业务：从事半导体测试设备的制造、进口、出口、经销、装配、维修、买卖等业务，并提供与半导体行业相关的研究、技术、科学和咨询服务。

8、股权结构：马来西亚槟城金海通为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、主要财务数据和指标：

金额单位：人民币万元

项目	2025年12月31日/2025年度
资产总额	4,761.40
负债总额	2,212.84
净资产	2,548.56
营业收入	97.42
净利润	-904.41
扣除非经常性损益后的净利润	-928.24

注：上述财务数据未经审计。

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等内容以最终签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司提供担保是为满足及支持全资子公司生产经营所必要的融资需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司运营管理的实际需要。被担保方为公司全资子公司，属于公司的重要组成部分，生产经营情况稳定，财务和信用状况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项。公司对其日常经营活动决策能够有效控制，风险可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年2月3日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，根据公司生产经营的实际资金需求为全资子公司提供担保，符合公司实际经营情况和整体财务战略，有利于提高全资子公司的融资效率。担保对象为公司全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况，能有效地控制和防范风险。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次为全资子公司提供担保事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。公司本次为全资子公司提供担保事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件的相关规定。保荐机构对公司为全资子公司提供担保事项的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为662万元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的0.50%。本次新增担保事项审议通过后，公司对外担保总额为2,162万元，占公司最近一期经审计净资产的1.64%，均为对全资子公司提供的担保，无逾期担保情况。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日